

QJ

中华人民共和国航天行业标准

FL 6114

QJ 832B—2011
代替 QJ 832A—1998

航天用多层印制电路板试验方法

Test method of multilayer printed board for aerospace

2011—07—19 发布

2011—10—01 实施

国家国防科技工业局 发布

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 试验条件.....	2
5 试验方法.....	2
5.1 外观、基本尺寸和特征.....	2
5.1.1 概述.....	2
5.1.2 外观.....	2
5.1.3 基本尺寸和特征.....	2
5.2 显微剖切.....	4
5.2.1 显微剖切和检验.....	4
5.2.2 镀覆孔（金属化孔）壁厚度测量.....	4
5.2.3 层间重合度（方法II）.....	4
5.3 物理性能.....	5
5.3.1 弓曲和扭曲（翘曲度）.....	5
5.3.2 表面导体剥离强度.....	5
5.3.3 焊盘（连接盘）拉脱强度（粘合强度）.....	6
5.3.4 镀层附着力.....	7
5.3.5 模拟返工.....	8
5.3.6 可焊性.....	8
5.3.7 阻焊膜固化及附着力.....	9
5.3.8 热应力.....	9
5.3.9 耐热油性.....	9
5.3.10 吸湿性.....	9
5.3.11 印制插头金镀层孔隙率.....	10
5.4 化学性能.....	10
5.4.1 清洁度.....	10
5.4.2 耐溶剂性.....	10
5.5 铜镀层特性.....	10
5.6 电气性能.....	11
5.6.1 绝缘电阻.....	11
5.6.2 抗电强度（介质耐电压）.....	12
5.6.3 电路的导通.....	13
5.6.4 电路的短路.....	13
5.6.5 镀覆孔（金属化孔）电阻.....	13
5.6.6 互连电阻.....	14
5.6.7 特性阻抗.....	15
5.7 耐负荷振动和耐负荷冲击.....	15

QJ 832B—2011

5.8 盐雾.....	15
附录 A（规范性附录） 多层板附连测试板和综合测试板表层图形.....	16